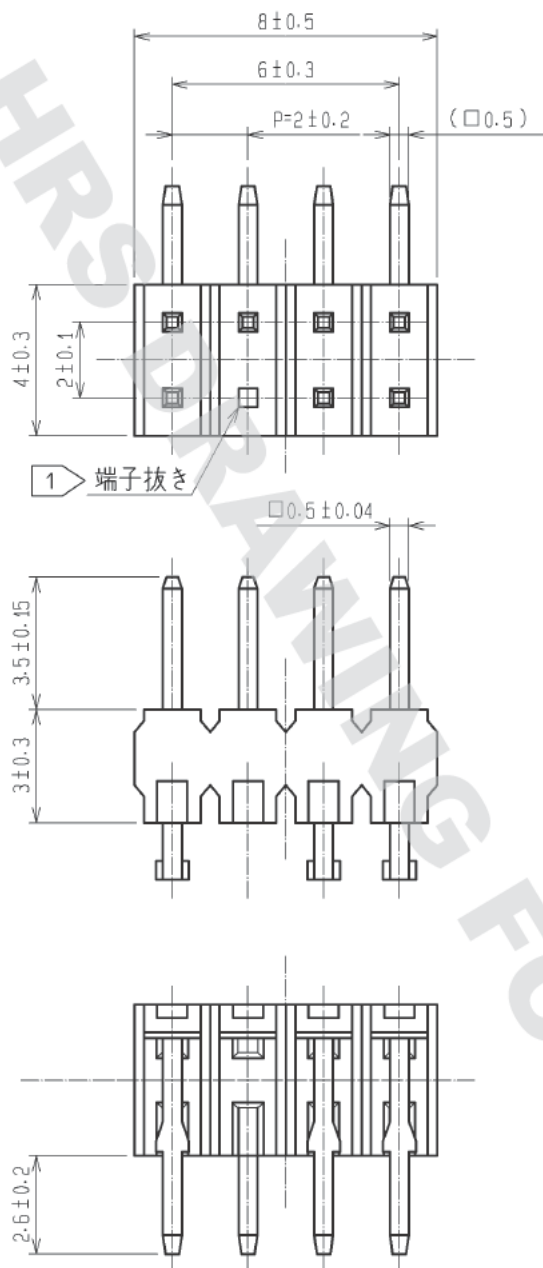
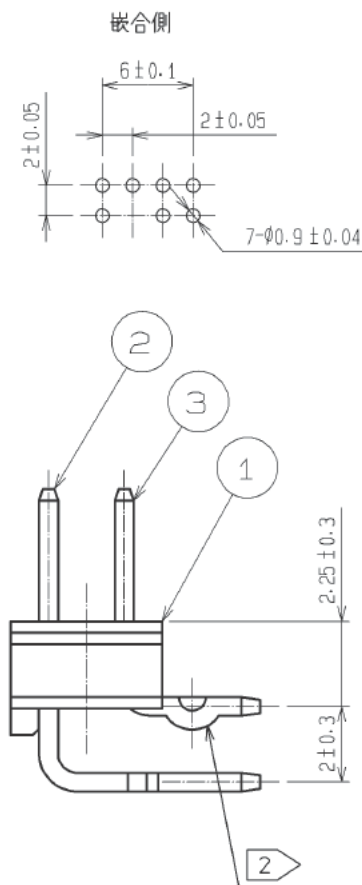


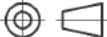
A
B
C
D
E
F



推奨基板寸法図(2:1)



- 注 ① 本製品は、端子1本抜き仕様とします。
② キンクの適合基板は、厚み1.6mmとします。
また、キンク加工箇所は任意の1端子おきとし、加工数は2本とします。
3. () 内寸法は、参考値を示します。

1	ポリアミド樹脂	クロ	UL94V-0	2,3	黄銅	接触部:金めっき0.05μm min. ディップ部:純すずめっき2μm min. 下地:ニッケルめっき2.5μm min.				
部番	材 質	処 理 , 備 考			部番	材 質	処 理 , 備 考			
UNITS mm		SCALE 5 : 1		△の数	訂 正 記 事		設 計		検 図	年月日
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : HS.OKAWA			09.06.02		図番: ADC4-080112-23			
		検 図 : HT.YAMAGUCHI			09.06.02		製品名: A3B-8PA-2DS(81)			
		設 計 : TP.MATSUMOTO			09.06.01		製品コード: CL621-0353-0-81			
		製 図 : TP.MATSUMOTO			09.06.01		 1/1			

A
B
C
D
E
F